



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208507664 U

(45)授权公告日 2019.02.15

(21)申请号 201821316565.0

(22)申请日 2018.08.15

(73)专利权人 杭州排列科技有限公司

地址 310000 浙江省杭州市余杭区五常街  
道文一西路998号19幢502室

(72)发明人 陈薇 段兆阳 夏真

(51)Int.Cl.

H01L 23/495(2006.01)

H01L 23/367(2006.01)

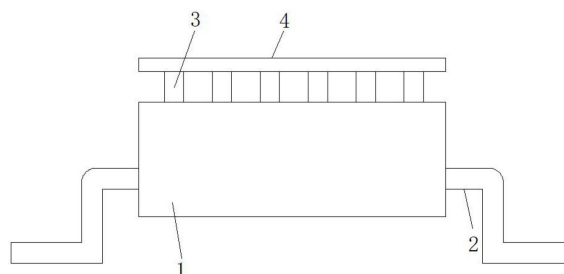
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

### (54)实用新型名称

一种大容量数据读写存储器

### (57)摘要

本实用新型公开了一种大容量数据读写存储器,包括外壳,所述外壳由上壳盖和底板组成,且上壳盖安装在底板上,所述底板置于上壳盖的表面上安装有芯片,且芯片的两侧焊接有引脚,所述引脚穿过上壳盖,所述上壳盖上表面设有散热片,以及散热片的底端焊接有T型头,所述T型头活动连接在上壳盖壳体内,且上壳盖壳体相应位置设有插接槽。本实用新型通过在外壳的上壳盖上插接多组散热片,并在散热片的顶端连接散热平板,增加散热面积,以便更好的进行散热,且散热片利用T型头插接在上壳盖上,便于达到可拆卸的目的,通过在上壳盖位于安装散热片的插接槽的底面设置铺设镂空网,利用镂空网改变传统的采用整体密封的方式,镂空网增加散热出口的面积。



1. 一种大容量数据读写存储器,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)由上壳盖(14)和底板(5)组成,且上壳盖(14)安装在底板(5)上,所述底板(5)置于上壳盖(14)的表面上安装有芯片(6),且芯片(6)的两侧焊接有引脚(2),所述引脚(2)穿过上壳盖(14),所述上壳盖(14)上表面设有散热片(3),以及散热片(3)的底端焊接有T型头(10),所述T型头(10)活动连接在上壳盖(14)壳体内,且上壳盖(14)壳体相应位置设有插接槽,所述散热片(3)的顶端焊接在散热平板(4)上,所述上壳盖(14)位于插接槽内壁的位置设有镂空网(9),所述引脚(2)底端连接焊接脚(8),且焊接脚(8)上开设有凹孔槽(11),所述焊接脚(8)上设有通孔(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种大容量数据读写存储器,其特征在于:所述通孔(12)均匀分布在焊接脚(8)上。

3. 根据权利要求1所述的一种大容量数据读写存储器,其特征在于:所述散热片(3)间隔分布在外壳(1)的上壳盖(14)表面且设置多组。

4. 根据权利要求1所述的一种大容量数据读写存储器,其特征在于:所述芯片(6)两侧的引脚(2)并排设有多个。

5. 根据权利要求1所述的一种大容量数据读写存储器,其特征在于:所述引脚(2)为L型,且引脚(2)与焊接脚(8)连接的位置采用加厚弯脚(13)。

## 一种大容量数据读写存储器

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种存储器,特别涉及一种大容量数据读写存储器。

### 背景技术

[0002] 存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等;在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等。计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。但是大容量数据读写存储器在使用过程中会产生大量的热量,且容易因为高温使得内部芯片烧毁,再将存储器焊接在电路板上时,容易使得焊接不紧密,造成脱落,为此,我们提出一种大容量数据读写存储器。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种大容量数据读写存储器,通过在外壳的上壳盖上插接多组散热片,并在散热片的顶端连接散热平板,增加散热面积,以便更好的进行散热,且散热片利用T型头插接在上壳盖上,便于达到可拆卸的目的,通过在上壳盖位于安装散热片的插接槽的底面设置铺设镂空网,利用镂空网改变传统的采用整体密封的方式,镂空网增加散热出口的面积,使得热量更加便于输出,可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0005] 一种大容量数据读写存储器,包括外壳,所述外壳由上壳盖和底板组成,且上壳盖安装在底板上,所述底板置于上壳盖的表面上安装有芯片,且芯片的两侧焊接有引脚,所述引脚穿过上壳盖,所述上壳盖上表面设有散热片,以及散热片的底端焊接有T型头,所述T型头活动连接在上壳盖壳体内,且上壳盖壳体相应位置设有插接槽,所述散热片的顶端焊接在散热平板上,所述上壳盖位于插接槽内壁的位置设有镂空网,所述引脚底端连接焊接脚,且焊接脚上开设有凹孔槽,所述焊接脚上设有通孔。

[0006] 进一步地,所述通孔均匀分布在焊接脚上。

[0007] 进一步地,所述散热片间隔分布在外壳的上壳盖表面且设置多组。

[0008] 进一步地,所述芯片两侧的引脚并排设有多个。

[0009] 进一步地,所述引脚为L型,且引脚与焊接脚连接的位置采用加厚弯脚。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0011] 1、本实用新型通过在外壳的上壳盖上插接多组散热片,并在散热片的顶端连接散热平板,增加散热面积,以便更好的进行散热,且散热片利用T型头插接在上壳盖上,便于达到可拆卸的目的。

[0012] 2、本实用新型通过在上壳盖位于安装散热片的插接槽的底面设置铺设镂空网,利用镂空网改变传统的采用整体密封的方式,镂空网增加散热出口的面积,使得热量更加便于输出。

[0013] 3、本实用新型通过在引脚的焊接脚上开设有凹孔槽，并在焊接脚上设置通孔，便于在与焊料接触时，可充分与之接触，以便保证焊接的效果。

#### 附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种大容量数据读写存储器的整体结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型一种大容量数据读写存储器的内部结构示意图。

[0016] 图3为本实用新型一种大容量数据读写存储器的焊接脚结构示意图。

[0017] 图中：1、外壳；2、引脚；3、散热片；4、散热平板；5、底板；6、芯片；8、焊接脚；9、镂空网；10、T型头；11、凹孔槽；12、通孔；13、加厚弯脚；14、上壳盖。

#### 具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0019] 如图1-3所示，一种大容量数据读写存储器，包括外壳1，所述外壳1由上壳盖14和底板5组成，且上壳盖14安装在底板5上，所述底板5置于上壳盖14的表面上安装有芯片6，且芯片6的两侧焊接有引脚2，所述引脚2穿过上壳盖14，所述上壳盖14上表面设有散热片3，以及散热片3的底端焊接有T型头10，所述T型头10活动连接在上壳盖14壳体内，且上壳盖14壳体相应位置设有插接槽，所述散热片3的顶端焊接在散热平板4上，所述上壳盖14位于插接槽内壁的位置设有镂空网9，所述引脚2底端连接焊接脚8，且焊接脚8上开设有凹孔槽11，所述焊接脚8上设有通孔12。

[0020] 本实施例中(如图1-2所示)，外壳1的上壳盖14上插接多组散热片3，并在散热片3的顶端连接散热平板4，增加散热面积，以便更好的进行散热。

[0021] 其中，所述通孔12均匀分布在焊接脚8上。

[0022] 本实施例中(如图3所示)，利用通孔12使得焊料与之充分接触。

[0023] 其中，所述散热片3间隔分布在外壳1的上壳盖14表面且设置多组。

[0024] 本实施例中(如图1-2所示)，利用多组散热片3增加散热面积。

[0025] 其中，所述芯片6两侧的引脚2并排设有多个。

[0026] 本实施例中(如图1-2所示)，便于利用引脚2将芯片6与电路板进行连接。

[0027] 其中，所述引脚2为L型，且引脚2与焊接脚8连接的位置采用加厚弯脚13。

[0028] 本实施例中(如图2所示)，利用加厚弯脚13可增加引脚2与焊接脚8的连接牢固度。

[0029] 需要说明的是，本实用新型为一种大容量数据读写存储器，工作时，将散热片3底端的T型头10插接到外壳1的上壳盖14的插接槽内，且散热片3顶端焊接有散热平板4，便于在使用时，利用散热平板4和散热片3增加散热的面积，以便更好的进行散热，且上壳盖14位于安装散热片3的插接槽的底面设置铺设镂空网9，利用镂空网9改变传统的采用整体密封的方式，镂空网9增加散热出口的面积，使得热量更加便于输出，其中，散热片3的拆卸十分便捷，在焊接时，由于引脚2的焊接脚8上开设有凹孔槽11，并在焊接脚8上设置通孔12，当焊接脚8与焊料接触时，焊料进入通孔12和凹孔槽11，使之可充分接触，以便保证焊接的效果。

[0030] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

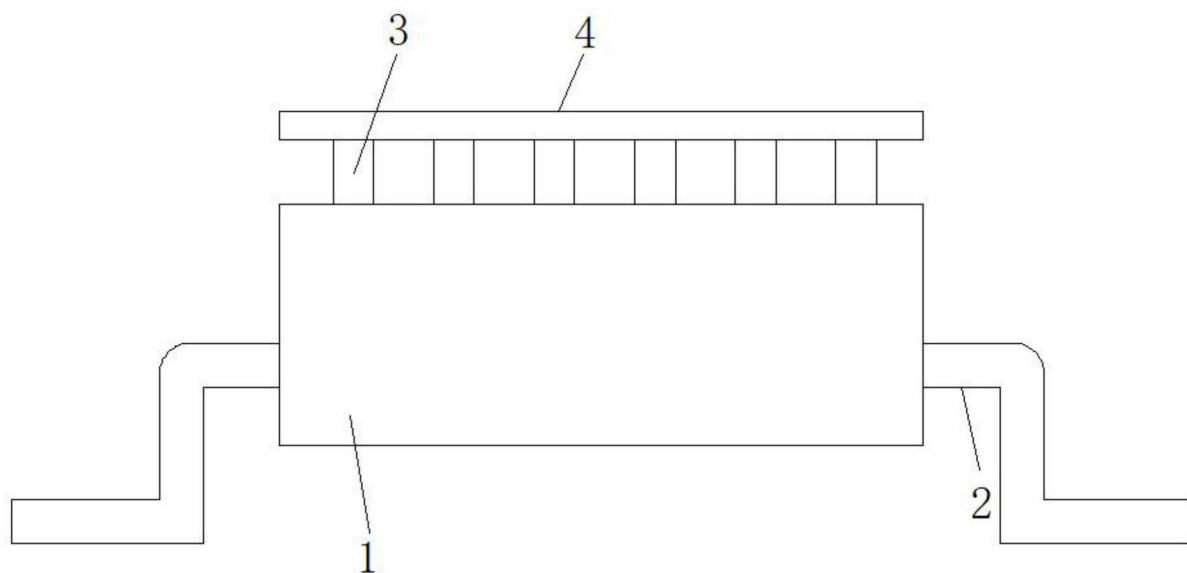


图1

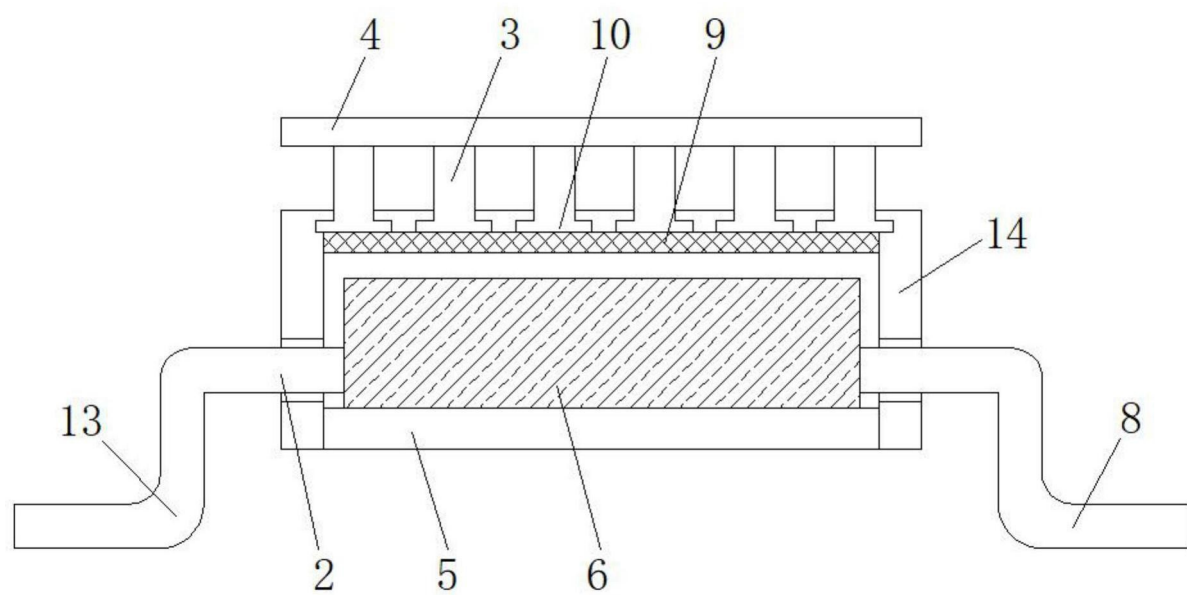


图2

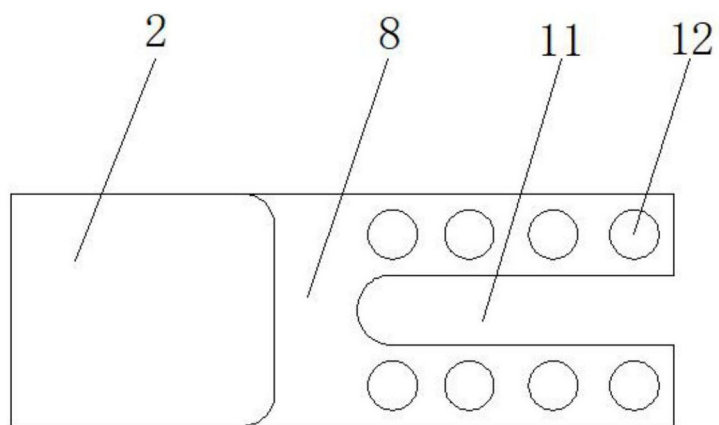


图3